

MIRDC-105-A20L

全球半導體後段半 導體檢測設備市場 動向與展望

作者：方 柏 文

執行單位：財團法人金屬工業研究發展中心

中華民國一〇五年六月

目錄

■ 摘要	1
■ 半導體後段半導體高階檢測設備	2
■ 結論	11



全球半導體後段半導體檢測設備市場 動向與展望

金屬中心 MII 產業分析師 方柏文

摘要：

半導體設備製程中，區分為前段與後段半導體設備。一般而言，半導體後段檢測設備，均圍繞在預燒測試系統，由於技術門檻比較低，因此雖目前全球主要半導體設備廠有進行生產，但生產的比例不高，而形成目前半導體後段檢測設備目前的市場狀況，本文將進行技術動向與分析未來展望。

《全球半導體後段半導體檢測設備市場動向與展望》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

匯款資訊 | 收款銀行：兆豐銀行南台北分行 (銀行代碼：017)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：39205104110018 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>